Теплопроводность нанокомпозита опал+эпоксидная смола при низких температурах

© В.Н. Богомолов, Д.А. Курдюков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек*, А. Ежовский*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия * Институт низких температур и структурных исследований Польской академии наук, 50-950 Вроцлав, Польша

E-mail: igor.smirnov@pop.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 30 июня 2004 г.)

В интервале 5–100 К измерена теплопроводность нанокомпозита опал+эпоксидная смола при 100% заполнении пустот первого порядка опала эпоксидной смолой. При $T < T_0$ (T_0 — температура, при которой теплопроводность эпоксидной смолы становится равной теплопроводности аморфных сфер SiO₂ опала с учетом их пористости за счет пустот второго и третьего порядков) обнаружено резкое уменьшение теплопроводности нанокомпозита опал+эпоксидная смола, которое качественно объясняется возникновением теплового сопротивления Капицы на контакте аморфных сфер опала и эпоксидной смолы.

Работа выполнена в рамках двустороннего соглашения между Российской и Польской академиями наук, при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 02-02-17657) и Польского государственнго комитета по научным исследованиям (KBN, грант N 3 T08A 054 26).

Настоящая работа является заключительной в цикле наших исследований теплопроводности нанокомпозитов опал+эпоксидная смола [1,2].

Напомним основные особенности необычной кристаллической структуры опала [3,4], сведения о которых будут необходимы при анализе полученных результатов.

Кристаллическая структура опала конструируется из плотноупакованных сфер аморфного SiO₂. В нашем эксперименте использовались опалы с диаметрами сфер $\sim 2000-2500$ Å (сферы первого порядка). Эти сферы содержат в себе набор плотноупакованных сфер меньшего размера $\sim 300-400$ Å (сферы второго порядка), которые в свою очередь формируются из плотноупакованных сферических частиц с размерами ~ 100 Å (сферы третьего порядка).

В решетке плотноупакованных сфер имеются пустоты октаэдрического и тетраэдрического типов, связанные между собой постредством каналов в форме рупоров. В зависимости от порядкового номера сфер аморфного SiO₂ эти пустоты также подразделяются на пустоты первого, второго и третьего порядков. Суммарная теоретическая пористость опала равна 59%.

Однако реально у выращенных нами монокристаллов опалов (из-за частичного спекания аморфных сфер второго и третьего порядков) она составляла ~ 46% [5]. Объем пустот первого порядка был ~ 26%. Аморфные сферы SiO₂ и пустоты первого порядка опала образуют гранецентрированные кубические решетки, параметры которых у использованного в эксперименте опала были ~ 3000-4000 Å. Пустоты первого порядка опала с помощью различных методов (химических, введения вещества из расплава под давлением или путем простой пропитки образца материалом наполнителя) можно заполнять металлами, полупроводниками, изоляторами и таким образом конструировать на его основе (при 100%

заполнении пустот первого порядка) регулярные трехмерные нанокомпозиты, которые можно рассматривать как систему, состоящую из двух "вставленных" друг в друга уникальных правильных решеток (решетки опала и решетки наполнителя) с гигантскими параметрами и гигантскими "атомными" массами.

В [6] показано, что в интервале температур 5-300 К теплопроводность \varkappa монокристаллов синтетических опалов определяется в основном качеством контактов между аморфными сферами SiO₂ (т. е. обусловлена контактными тепловыми сопротивлениями между этими сферами). Чем более совершенна кристаллическая структура опала (когда контакты между всеми сферами строго одинаковы и приближаются к точечным), тем меньше становится его теплопроводность.

Согласно приведенной выше схеме кристаллической решетки нанокомпозита на основе опала, тепловой поток в нем будет распространяться по двум параллельным каналам, сферам аморфного SiO₂, образующим опал, и по "цепочкам" из материала наполнителя: тетраэдрическая (октаэдрическая) заполненная пустота– заполненный рупорообразный канал–тетраэдрическая (октаэдрическая) заполненная пустота– заполненный рупорообразный канал и т.д.

При этом возможны три варианта:

- 1) \varkappa (наполнителя) $\gg \varkappa$ (матрицы опала);
- 2) \varkappa (наполнителя) $\ll \varkappa$ (матрицы опала);
- 3) \varkappa (наполнителя) $\approx \varkappa$ (матрицы опала).

Первый вариант характерен для нанокомпозитов опал + HgSe [6] и опал + NaCl [7], в которых тепловой поток распространяется преимущественно по "цепоч-кам" из материала наполнителя. При низких температурах (5-20 K) теплопроводности HgSe и NaCl, находящиеся в пустотах первого порядка опалов, определяются граничным рассеянием фононов на узких местах ("шей-

ках") рупорообразных каналов (~ 100 Å), соединяющих запоненные октаэдрические (тетраэдрические) пустоты опала. В этом случае длины свободного пробега фононов (l) намного больше размеров "шеек".

При высоких температурах (до 300 K) *l* становится меньше размеров рупорообразных каналов, и более низкие значения теплопроводности материалов наполнителей по сравнению с объемными кристаллами объясняются наличием в них специфических дефектов (вакансии-разрывы в решетке наполнителя, поверхностные дефекты, дефекты, обусловленные напряжениями в матрице наполнителя, и т.д.), которые отсутствуют в объемных материалах.

Второй вариант реализуется для нанокомпозита опал + эпоксидная смола для T > 100 K [2]. В этом варианте тепловой поток при измерении теплопроводности нанокомпозита распространяется преимущественно по матрице (аморфным сферам SiO₂) и теплопроводность нанокомпозита близка к теплопроводности матрицы опала.

Третий вариант предполагалось осуществить при измерении теплопроводности нанокомпозита опал + эпоксидная смола для *T* < 100 К. Этому вопросу и будет посвящена настоящая работа.

Для приготовления нанокомпозита опал + эпоксидная смола на основе монокристаллического опала мы воспользовались методикой, описанной в [1,2]. Был получен нанокомпозит со 100% заполнением пустот первого порядка опала эпоксидной смолой (опал + 100% эпоксидной смолы).

Измерение теплопроводности нанокомпозита проводилось в интервале температур 5–300 К на установке, аналогичной [8]. Измеренная на эксперименте теплопроводность является теплопроводностью кристаллической решетки.

Из данных работы [2] можно заключить, что теплопроводность эпоксидной смолы будет близка к теплопроводности плавленого кварца при температурах ниже 100 К.

Эпоксидная смола, введенная в пустоты первого порядка опала, контактирует в нем с аморфными сферами SiO₂, имеющими в нашем случае пористость $\sim 20\%$, которая возникает за счет пустот второго и третьего порядков опала.

На части рисунка *а* приведены значения теплопроводности аморфного кварца [9] и аморфных сфер SiO₂ опала (\varkappa_0) с учетом отмеченной выше пористости. Расчет проводился по формуле Литовского (1) [10]

$$\varkappa_0 = \varkappa_{\mathrm{SiO}_2} (1-p) \sqrt{1-p},\tag{1}$$

р — пористость, которая была равна 0.2.



а) теплопроводность плавленого кварца (1) [9], аморфных сфер SiO₂ опала с учетом их пористости за счет пустот второго и третьего порядков (2) и нанокомпозита опал + 100% эпоксидной смолы (3). b) — теплопроводность эпоксидной смолы (4) [2], плавленого кварца (1) и аморфных сфер SiO₂ опала (2) с \varkappa_0 . c) — схематическое изображение нанокомпозита опал + эпоксидная смола. I — аморфные сферы SiO₂ опала с \varkappa_0 , 2 — эпоксидная смола. Q — направление распространения теплового потока в нанокомпозите.

приведены результаты для теплопроводности плавленого кварца и аморфных сфер SiO₂ опала.

Как видно из части *b*, при T < 30 К теплопроводность эпоксидной смолы становится близкой к теплопроводности аморфных сфер SiO₂ опала (\varkappa_0).

При такой ситуации можно было бы ожидать, что при $T < 30 \text{ K} \varkappa_{\text{comp}}$ будет возрастать с понижением температуры, стремиться к значению теплопроводности аморфных сфер SiO₂ опала и затем сравняется с ним.

Однако на эксперименте все обстоит иначе. При $T \approx T_0$ наблюдается не рост, а достаточно резкое уменьшение величины теплопроводности нанокомпозита (часть a)¹.

На том же рисунке представлены полученные экспериментальные результаты для теплопроводности нанокомпозита опал + 100% эпоксидной смолы (\varkappa_{comp}), а на части *b* вместе с нашими данными для теплопроводности эпоксидной смолы (\varkappa_{epox}) из [2] для сравнения

¹ Никаких изломов на зависимости теплопроводности от температуры (включая и район температур вблизи 30 K) у монокристалла опала, который был использован в качестве матрицы для нанокомпозита опал + эпоксидная смола, не наблюдалось.

Какой же механизм рассеяния фононов в композите ответственен за такое поведение $\varkappa_{comp}(T)$?

При условии, когда $\varkappa_0 \approx \varkappa_{epox}$ тепловой поток Q будет равномерно распределяться по образцу нанокомпозита (часть c) и "пересекать" границы между эпоксидной смолой и аморфными сферами SiO₂ опала. При этом в области низких температур может начать оказывать существенное влияние на поведение теплопроводности композита тепловое сопротивление Капицы (r_K) [11–13], которое возникает на границе двух сред в нанокомпозите из-за из акустического несовершенства (acoustic-mismatch).

Согласно теории [11–13], $r_{\rm K} \sim T^{-3}$ и пропорционально отношению акустических импедансов этих сред: $\bar{v} \cdot \rho$ (где \bar{v} — средняя скорость звука, ρ — плотность материала).

Чем больше величина отношения импедансов матрицы и наполнителя, тем выше значение $r_{\rm K}$.

Отношение импедансов для аморфного кварца/эпоксидная смола составляет 4.28 [14–16]. Эта величина достаточно большая. Например, для отношения импедансов аморфный кварц/NaCl она составляет лишь 1.449 [15–17].

На эксперименте мы не получили зависимости $r_{\rm K} \sim T^{-3}$. Она оказалась значительно меньше $(r \sim T^{-1.9})$. Такая же зависимость для r(T) была получена и в [13] при анализе данных для композита эпоксидная смола + медь, который проводился в рамках модели теплового сопротивления Капицы.

Таким образом, и в нашем случае можно говорить лишь о наличии качественного совпадения полученных результатов для нанокомпозита опал + эпоксидная смола с моделью теплового сопротивления Капицы.

Список литературы

- В.Н. Богомолов, Л.С. Парфеньева, Л.М. Сорокин, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, А. Ежовский, Дж. Хатчисон. ФТТ 44, 6, 1017 (2002).
- [2] В.Н. Богомолов, Н.Ф. Картенко, Д.А. Курдюков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Н.В. Шаренкова, Х. Мисиорек, А. Ежовский. ФТТ 45, 5, 910 (2003).
- [3] В.Г. Балакирев, В.Н. Петрановский, С.Г. Романов, Л.А. Самойлович. Кристаллография 33, 3, 111 (1993).
- [4] В.Н. Богомолов, Т.М. Павлова. ФТП 29, 5/6, 826 (1995).
- [5] В.В. Ратников. ФТТ **39**, *5*, 956 (1997).
- [6] В.Н. Богомолов, Н.Ф. Картенко, Д.А. Курдюков, Л.С. Парфеньева, В.В. Попов, Л.М. Сорокин, И.А. Смирнов, Х. Мисиорек, А. Ежовский, Дж. Хатчисон. ФТТ 45, 3, 535 (2003).
- [7] В.Н. Богомолов, Н.Ф. Картенко, Д.А. Курдюков, Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Н.В. Шаренкова, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский. ФТТ 46, 10, 1893 (2004).
- [8] A. Jezowski, J. Mucha, G. Pompe. J. Phys. D.: Appl. Phys. 20, 1500 (1987).
- [9] Теплопроводность твердых тел. Справочник / Под ред. А.С. Охотина. Энергоиздат, М. (1984). 320 с.

- [10] Е.Я. Литовский. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 16, 3, 559 (1980).
- [11] W.A. Little. Canad. J. Phys. 37, 334 (1959).
- [12] J.A. Katerberg, C.L. Reynolds, A.C. Anderson. Phys. Rev. B 16, 2, 673 (1977).
- [13] C. Schmidt. Cryogenics 15, 17 (1975).
- [14] K.W. Garret, H.M. Rosenberg. J. Phys. D.: Appl. Phys. 7, 1247 (1974).
- [15] H.J. McSkimin. J. Appl. Phys. 24, 8, 988 (1953).
- [16] J.J. Freeman, A.C. Anderson. Phys. Rev. B 34, 8, 5684 (1986).
- [17] Акустические кристаллы / Под ред. М.П. Шаскольской. Наука, М. (1982). 632 с.